【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和5年4月28日(2023.4.28)

【国際公開番号】WO2022/085451
【出願番号】特願2022-557408(P2022-557408)
【国際特許分類】
H01L 25/00(2006.01)
【FI】
H01L 25/00 B

【手続補正書】
【提出日】令和5年3月10日(2023.3.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１基板本体及び第１導体パターンを含んでいる第１基板、第２基板本体を含んでいる第２基板、半導体素子、アンテナ及び金属板を備えており、
前記第１基板本体は、上下方向に並ぶ第１基板本体上主面及び第１基板本体下主面を有しており、
前記第２基板本体は、上下方向に並ぶ第２基板本体上主面及び第２基板本体下主面を有しており、
前記第２基板本体は、前記第１基板本体上主面と前記第２基板本体下主面とが向かい合うように、前記第１基板本体の上に配置されており、
前記半導体素子は、前記第１基板本体下主面に実装されており、
前記アンテナは、前記第２基板本体に設けられており、
前記金属板の厚みは、前記第１導体パターンの厚みより大きく、
前記金属板は、上下方向に見て、前記半導体素子と重なるように、前記第１基板本体上主面に面接合されている、
電子機器。
【請求項２】
前記金属板は、上下方向に見て、前記アンテナと重なっている、
請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
前記電子機器は、
連結部を、
更に備えており、
前記第１基板本体、前記第２基板本体及び前記連結部は、一枚の樹脂基板に含まれており、
前記連結部は、前記第１基板本体と前記第２基板本体とを連結するように、上下方向に曲がっている、
請求項１又は請求項２のいずれかに記載の電子機器。
【請求項４】
前記第１導体パターンは、前記第１基板本体上主面に設けられており、
前記金属板は、前記第１導体パターンと電気的に接続されている、
請求項１ないし請求項３のいずれかに記載の電子機器。

【請求項５】
前記電子機器は、
前記第１導体パターンの上に設けられている接続導体と、
前記金属板を前記第１基板本体上主面に面接合させる絶縁樹脂層と、
を更に備えており、
前記金属板は、前記接続導体を介して、前記第１導体パターンと電気的に接続されている、
請求項４に記載の電子機器。
【請求項６】
前記電子機器は、
前記金属板を前記第１基板本体上主面に面接合させると共に、前記金属板と前記第１導体パターンとを電気的に接続する異方性導電膜を、
更に備えている、
請求項４に記載の電子機器。
【請求項７】
前記電子機器は、
前記第１基板及び前記第２基板の内の一方を支持する筐体と、
前記第１基板及び前記第２基板の内の他方を支持し、前記筐体に支持される支持部材と、
を更に備えている、
請求項１ないし請求項５のいずれかに記載の電子機器。
【請求項８】
前記電子機器は、
前記第２基板本体下主面と前記金属板との間に設けられているスペーサーを、
更に備えている、
請求項１ないし請求項６のいずれかに記載の電子機器。
【請求項９】
前記電子機器は、
前記金属板と電気的に接続されている金属物品を、
更に備えている、請求項１ないし請求項８のいずれかに記載の電子機器。
【請求項１０】
前記アンテナは、前記半導体素子と電気的に接続されている、
請求項１ないし請求項９のいずれかに記載の電子機器。
【請求項１１】
前記半導体素子は、ＲＦＩＣである、
請求項１ないし請求項１０のいずれかに記載の電子機器。
【請求項１２】
前記アンテナは、前記半導体素子が出力する送信信号を電磁波として放射する、及び／又は、前記アンテナは、受信した電磁波を受信信号として前記半導体素子に出力する、
請求項１１に記載の電子機器。
【請求項１３】
前記金属板は、グランド電位に接続されている、
請求項１ないし請求項１２のいずれかに記載の電子機器。